

## **Описание SURVOS PLUS L:**

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) SURVOS PLUS L соответствует строгим требованиям пищевой продукции по санитарному надзору за качеством правил США в соответствии с п. 21 CFR 178.3120, LGFB §30 и §31, а также (ЕЭС) № 1935/2004. SURVOS PLUS L обладает высокой смазывающей способностью и испаряется на 100%.

Смазывающая способность SURVOS PLUS L очень высока и сопоставима с СОЖ на нефтяной основе. Для 100%-но испаряющихся СОЖ для обработки материалов смазывающая способность SURVOS PLUS L очень высока. Еще одним преимуществом SURVOS PLUS L является его хорошие охлаждающие свойства. SURVOS PLUS L может быть использован со всеми материалами, за исключением некоторых пластиков.

Насколько известно, никогда не возникало никакой реакции/взаимодействия SURVOS PLUS L с любыми материалами (кроме некоторых пластиков) за более чем 40 лет его применения. В этом же интервале времени не было зафиксировано ни разу никаких раздражений или заболеваний кожи, которые бы могли бы быть вызваны SURVOS PLUS L.

## **SURVOS PLUS L показывает прекрасные результаты при следующих видах обработки:**

- Пиление, сверление, гравировка и т.д. с высокими параметрами обработки и долговечности инструмента.
- Штамповка, профилирование, вытяжка и гибка цветных металлов, алюминия, меди и латуни.
- Гибка латуни, стали, оцинкованной стали, стали с порошковым покрытием и листов из нержавеющей стали.

## **SURVOS PLUS L показывает также хорошие результаты при такой обработке, как:**

- Точная механическая обработка (тонкая шлифовка / финиширование отделка), тяжёлое точение, фрезерование и гравировка стали.
- Обработка композитных материалов, например: изготовление печатных плат.
- Сборочные технологии.
- Обработка бумаги и деревообработка.

Параметры SURVOS PLUS L	Значения
Цвет	Бесцветный
Плотность	0,72 - 0,85 g/cm <sup>3</sup> (20° C)
Кинематическая вязкость	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> /s (20° C)
Точка вспышки	> 61° C
Точка кипения/диапазон кипения	> 160 - 260°C

Для идеального результата использования SURVOS Plus L продукт должен наноситься в виде тонкой пленки. Вы можете достичь этого с использованием системы HPM MQL TCL-System.